

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-PRO PE CONTACT L3 - 2200163

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



PE-Kontakt für UM-PRO-Aufbaugeschäft zur Verbindung der Leiterplatte auf Level 3 mit der Tragschiene

Abbildung zeigt die Variante für Leiterplattenlevel 1

Produkteigenschaften

- Steckmontage verkürzt Montagezeit und spart dadurch Kosten
- Randnahe Bestückung schafft Verdrahtungsvorteile
- Frei positionierbare Abdeckhauben bieten Flexibilität
- Beidseitig bestückbare PE-Kontakte sorgen für Sicherheit
- Zusatzfüßelemente erhöhen mechanische Stabilität
- Temperaturbereich bis 100°C erweitert Einsatzgebiete (UM-PRO)
- BUS-Querkontaktierung erweitert Gerätekommunikation
- Zusatzbeschriftung der Leiterplatte durch Phoenix-Modulbezeichnungsträger PMB (Bohrloch-Durchmesser 4 mm)
- Durchdachte Profilgeometrie erhöht die Formstabilität

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20
GTIN	4046356547246

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27400603
eCl@ss 7.0	27182701
eCl@ss 8.0	27182701

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC000275
ETIM 5.0	EC000275

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-PRO PE CONTACT L3 - 2200163

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>